盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2025 年 2 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下：

一、行动方案相关措施的实施情况及效果

（一）聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力

1、精耕细作专业领域，实现业绩稳步增长

公司在半导体专用设备领域持续精耕细作，以客户需求为导向，凭借技术差异化优势，为客户提供专业、稳定、高效、细致的产品与服务。2025 年上半年，公司经营业绩相比去年同期继续保持增长，2025 年 1-6 月共实现营业收入 326,529.18 万元，同比增长 35.83%，实现归属于上市公司股东净利润 69,577.27 万元，同比增长 56.99%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 67,427.98 万元，同比增长 55.17%。

2、坚持差异化创新，加强研发投入、技术人才建设与技术成果转化

2025 年上半年，公司继续专注于半导体专用设备的生产、研发，不断升级、迭代产品技术，并保持高强度的研发投入，实现技术、工艺的长期积累和应用。公司 2025 年 1-6 月研发投入为 54,438.36 万元，同比增加 39.47%，占公司同期营业收入的比例为 16.67%。同时，公司非常重视技术人才建设，通过市场招聘、内部培养等方式，不断扩充自身的技术人才队伍，截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 1,080 人，占公司员工总数的 48.96%，较上年末增长了 39.18%。

在专利获取方面，2025年上半年，公司及其子公司共申请专利230项，新获授专利18项。截至2025年6月30日，公司及其子公司累计申请专利1,800项，已经获授专利494项（其中发明专利共计489项），比上年末增长了5.11%，其中境内授权专利189项，境外授权专利305项。

在技术成果应用和“落地”方面，2025年3月，公司的单晶圆中/高温硫酸过氧化混合物（SPM）设备已成功通过一家逻辑芯片制造商的大批量制造验证，该设备采用公司全新的专有喷嘴设计以消除SPM工艺中的酸雾飞溅问题，有助于提高颗粒控制能力并减少腔体的清洗维护频率，从而延长设备的正常运行时间。目前该设备已经交付多家客户。在同月的SEMICON CHINA 2025展会上，公司作为技术差异化高端半导体设备供应商亮相了Tahoe-SPM清洗设备、单片高温硫酸清洗设备、单片清洗及超临界二氧化碳干燥设备、背面清洗设备、边缘湿法刻蚀设备、面板级先进封装电镀设备、原子层沉积炉管设备、PECVD设备、Track设备等产品，为行业内的客户带来了更优质、更领先的半导体专用设备及工艺解决方案。2025年6月，公司ECP设备1500电镀腔顺利交付，此次交付的ECP设备1500电镀腔，在稳定性、精度和效率等方面均达到了行业领先水平，能够满足客户在半导体制造过程中的多样化需求。

除此之外，2025年3月，公司自主研发的面板级水平电镀设备，斩获由美国3D InCites协会颁发的“Technology Enablement Award”奖项。公司长久秉持的“技术差异化”战略所形成的创新成果和技术实力受到了国际认可。

3、稳妥推进再融资事项

2025年6月6日，公司向特定对象发行股票事项经上海证券交易所审核通过。2025年6月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1338号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次再融资的募投项目“研发和工艺测试平台建设项目”、“高端半导体设备迭代研发项目”，均能促进公司进一步向前沿技术领域发展，研发更高工艺等级的半导体专用设备产品，提升产品工艺技术能力与科技创新水平，持续提升差异化科技创新实力。

（二）募投项目的推进与管理

截至 2025 年 6 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“盛美半导体设备研发与制造中心”、“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“补充流动资金”和“高端半导体设备拓展研发项目”均已完成投入或达到预定可使用状态，上述募投项目全部完成结项。截至 2025 年 6 月 20 日，上述募投项目的募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金金额 (A)	累计已投入金额 (B)	利息及理财收益扣除手续费净额 (C)	尚未使用募集资金 (D=A-B+C)
1	盛美半导体设备研发与制造中心	156,890.00	144,500.00	125,697.01	255.66	19,058.65
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	45,000.00	45,000.00	45,458.74	458.74	-
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	-
4	高端半导体设备拓展研发项目	74,773.07	73,087.15	74,434.75	1,347.60	-
合计		341,663.07	327,587.15	310,590.50	2,062.00	19,058.65

注 1：累计已投入金额包含募集资金存放期间产生的银行存款利息；

注 2：“盛美半导体设备研发与制造中心”项目尚未使用募集资金为该项目需用于支付已签订合同但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投入、建设和执行完毕，将进一步提升公司的科技创新实力与核心竞争力，助力公司跻身世界一流集成电路装备企业行列。

（三）优化运营管理，强化人才激励

2025 年上半年公司存货周转率提高至 5.36(年化)，综合毛利率达到 50.73%，依然维持在较高水平。公司为建立健全长效激励机制，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，充分调动员工的积极性和创造性，以进一步吸引和留住优秀人

才，2025年3月，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。该计划本次激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理（业务）骨干、中层管理（业务）人员以及优秀基层技术（业务）员工，总计466人，认购股票数量2,550,435股，授予价格49.15元/股。

（四）完善公司治理，推动公司高质量发展

2025年上半年，公司依据新《公司法》等相关法律、法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修订、完善，以防范各类风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性。同时在此期间，公司亦持续夯实ESG管理水平，实现可持续发展。

1、依据相关法规，调整公司治理结构

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。公司按照新《公司法》及证监会配套制度规则等规定，取消公司监事会，将原监事会职责交由董事会审计委员会行使，此外，为进一步完善公司治理结构，提高决策的科学性、可靠性，切实保护股东利益，公司董事会人数由6人增加至8人，其中非独立董事人数由3人调整为4人，独立董事人数由3人调整为4人。公司新聘任独立董事、职工代表董事各1名。

2、进一步完善公司治理相关制度

公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《独立董事专门会议工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等23项公司治理制度进行修订或制定，进一步完善法人治理和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

3、夯实ESG管理水平，实现可持续发展

2025年上半年,国际与中国各大ESG评级机构公布了其2024年度评级结果,公司在MSCI ESG Rating、中证ESG评级、Wind ESG评级、中诚信绿金ESG评级、华证ESG评级、商道融绿ESG评级等各大ESG评级体系中的评级均得到提升。其中,公司在中证ESG评级、Wind ESG评级均由BB级提升至A级,中诚信绿金ESG评级由BBB级提升至A-级,MSCI ESG Rating由B级提升至BB级,华证ESG评级由CCC级提升至BB级,商道融绿ESG评级由B-级提升至B+级。评级结果全面提升体现公司在国际和中国主流ESG评级体系中的表现进一步得到认可,反映了公司在环境、社会及公司治理方面的持续改进和实践深化,取得丰硕成果。

(五) 持续加强投资者沟通交流,提升信息披露透明度

2025年上半年,公司通过上交所E互动平台、业绩说明会、投资者交流会、投资者热线电话、电子邮件等多种渠道,积极与投资者沟通,增强信息透明度和管理规范性,保障广大投资者的知情权,具体包括:

2025年3月18日,公司通过进门财经平台举办了2024年度业绩交流会,对2024年全年业绩和财务情况进行了介绍,并就投资者关心的问题进行了回复。

2025年4月10日,公司通过上证路演中心举办了2024年度业绩暨现金分红说明会,公司董事长HUI WANG,总经理王坚,独立董事ZHANBING REN,财务负责人LISA YI LU FENG,董事会秘书罗明珠参加了会议,针对2024年度经营业绩及现金分红情况与投资者进行交流和互动,并就投资者提出问题进行了回复。

2025年5月15日,公司通过进门财经平台举办了2025年第一季度业绩交流会,对2025年第一季度业绩和财务情况进行介绍,并就投资者关心的问题进行了回复。

2025年6月12日,公司在临港研发与制造中心成功举办2025年投资者开放日活动,当日举行多场投资者交流活动,吸引众多个人投资者、机构投资者与行业分析师现场参与。公司董事长HUI WANG、总经理王坚、财务负责人LISA FENG、副总经理陈福平、董事会秘书罗明珠等管理层出席活动,并与投资者深入交流。活动当天安排了实地参观、专题讲解与互动问答等多个环节,全面展示公司在产品布局、技术创新、全球化战略等方面的最新进展。此次活动不仅增强了投资者

对公司的了解，也体现公司持续推进高质量投资者关系管理的坚定态度。

2025年上半年，公司通过上证E互动平台，共收到投资者提问13项，回复13项。公司通过以上举措多途径、全方位、及时传达公司的投资价值，在确保合规的前提下让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增强投资者对公司的信心和信任，吸引更多的投资者，特别是中长期资金参与，努力夯实资本市场高质量发展基础。

（六）持续完善投资者回报机制，提升投资价值，增强投资者信心

2025年上半年，公司持续努力践行《盛美半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》以及董事长 HUI WANG 先生的分红提议，积极推进2024年度利润分配以及实施公司股份回购，以增强投资者信心和价值获得感，让投资者共享公司的发展成果。

公司于2025年2月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2025年6月12日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，截至2024年12月31日，公司总股本为438,740,753股，以剔除已回购股份0股后的总股本为基准，拟每10股派发现金红利6.57元（含税），共计派发现金红利288,252,674.72元（含税），本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的25.00%。考虑到2025年上半年，公司实施《2023年限制性股票激励计划》以及股份回购，导致参与本次分红的股数发生变化。公司于2025年7月3日进行公告，将公司2024年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利0.65386元（含税），利润分配总额为288,252,734.66元（含税），具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度利润分配方案每股分红金额的公告》（公告编号：2025-050）。上述权益分派已于2025年8月1日实施完毕，具体详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054）。

2025年6月27日，公司实施了本次回购计划中的首次回购。截至2025年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份443,400股，占公司总股本441,291,188股的比例为0.10%，回购成交的最高价为115.49元/股，最低价为110.81元/股，支付的资金总额为人民币50,012,340.46元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-049）。

（七）强化“关键少数”风险共担及责任利益共享约束

为强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，同时兼顾“科学绩效考核”，加深“关键少数”与公司、中小股东的利益一致性。截至2025年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员（含2025年上半年离任的董事、高级管理人员）合计直接持有公司股票3,069,208股，较2024年末增加了41.16%。此举为践行“义利共生”的理念，向公众投资者以及中小股东传递对公司发展前景的信心。

二、投资者关于改进行动方案的意见建议

无。

三、进一步改进措施

2025年上半年，公司全面贯彻落实行动方案，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效，对推动公司长久发展具有重要意义。此外，公司将持续贯彻落实行动方案中的各项举措，通过更加专注主业和坚持差异化创新巩固和增强核心竞争力，通过更好的业绩表现回报投资者的信任，以及通过更规范高效的公司治理水平打造行业标杆。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月5日